

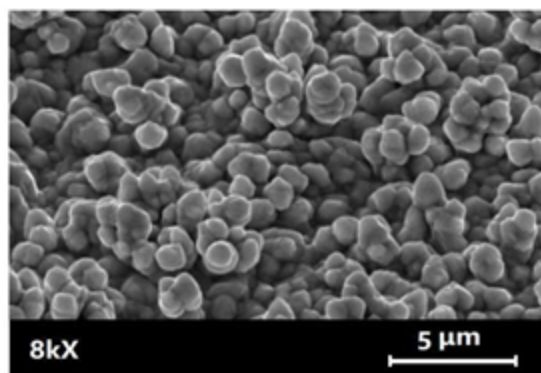
## 典型应用

- ★ BT/类BT
- ★ IC封装
- ★ 类载板(SLP)

## 典型特征

- ★ 超高抗拉强度
- ★ 低粗糙度

## 典型技术指标



项目		单位	性能参数		测试方法
标称厚度		μm	9	12	IPC-4562A
单位面积质量		g/m <sup>2</sup>	88	107	IPC-TM-650 2.2.12
抗拉强度	RT	MPa	500	500	IPC-TM-650 2.4.18
	180°C		200	200	
延伸率	RT	%	4.0	5.0	IPC-TM-650 2.4.18
	180°C		3.0	3.0	
粗糙度Rz	处理面	μm	3.5	3.5	IPC-TM-650 2.2.17
	非处理面		1.5	1.3	
剥离强度	BT	lb/in	2.5	3.5	IPC-TM-650 2.4.8

★ 以上数据为典型值，非保证值。

★ 半固化片会影响剥离强度，铜箔使用前请进行半固化片匹配实验或咨询德福科技技术服务人员。

网站: [www.jjdefu.com](http://www.jjdefu.com)

电话(传真) : 0792-8252044

地址: 江西省九江市汽车工业园顺意路15号

